

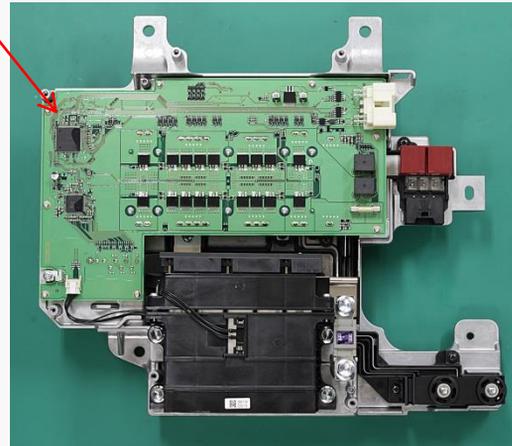
SUZUKI ワゴンR DAA-MH55S(2017年型)、デンソー製補助電源モジュール内制御基板の詳細回路解析レポートリリース

エルテックでは、2017年2月に発売されたSUZUKI ワゴンRに搭載されているデンソー製補助電源モジュール内制御基板をリリースしました。

解析対象基板



製品外観



製品内観

・本製品は、バッテリー容量が従来の約3.3倍となっており、モータの力だけで最長10秒間のクリープ走行を実現しています。

(2017年2月発売モデル プロフィール・基本スペックより抜粋)

主な特徴として

- 1) 4つのスイッチにより、Integrated Starter Generator (ISG)、Li-ion Battery、Lead-Acid Batteryと、BCM・Relay Box・Junction Box間の接続を切り替える構成
- 2) スイッチに異常が発生しても、リレーにより接続が補償される
- 3) バッテリーマネージメントは、Panasonic製のICを使用

本レポートでは、基板の各層のレイアウト、詳細回路図、機能ブロック図、部品表、基板配線のサイズ測長、が含まれます。(全57ページ)

販売価格(税別)¥1,100,000

17G-0001-1

Table of Contents

Standard	Page
1. Analysis summary	3
2. Components	4
3. Teardown	7
4. X-ray image of PCBs	12
5. PCB layout image of each layers	13
6. Component detail	16
7. Function block identification	19
8. Schematic	20
9. Component list	22
10. PCB interface connector details	45
11. Sensor	49
12. System	50
13. PCB layout size measurement	53
14. Comparison with S -Enecharge	57

17G-0001-1

